（上接B85版）

根据上市公司第三季度报告，2024年1-9月上市公司实现营业收入19,319.01万元且净利润为负。根据上市公司2024年年度业绩预亏公告，上市公司预计2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33,000.00万元到37,300.00万元，且净利润为负。前述财务数据未经审计，若上市公司最终经审计的2024年扣除后营业收入低于3亿元且净利润为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2024年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示（*ST）。若上市公司连续两年被实施退市风险警示，则上市公司将会退市，提请投资者注意相关风险。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、集成电路行业已成为我国和全球的基础核心产业，产业链安全具有重要地位

目前，集成电路产业已成为我国事关国家安全和发展全局的基础核心领域，是支撑国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，国家出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等多项支持政策，力求大力推动我国集成电路产业链的更好更快发展。

由于半导体产业在国家发展和竞争中的关键地位，美国、英国、德国、法国、加拿大、日本、俄罗斯等国家均出台了针对半导体产业的专项鼓励或扶持政策，以帮助本国企业发展和在全球范围内竞争。在此背景下，打造自主可控的半导体产业供应链、提升半导体产业供应链韧性和安全水平对于我国国家安全、经济发展和人民利益具有重要意义。

2、半导体材料是我国半导体产业链自主可控的关键根基，国产化率仍有待提升

半导体材料是制作分立器件、集成电路等半导体器件的重要材料。半导体材料的种类繁多，根据其生产工艺及性能可分为前道晶圆制造材料和后道封装材料两大类。根据国际半导体产业协会数据，2023年全球半导体材料市场规模为667亿美元，其中封装材料市场规模252亿美元。随着我国半导体产业链的持续发展，2023年中国大陆半导体材料市场规模131亿美元，在半导体行业下行波动期间仍逆势上涨0.9%。由于广泛的应用和庞大的市场规模，半导体材料对于我国半导体产业链的发展具有重要的基础支撑作用，自主可控的半导体材料供应链关系着整个半导体产业链的安全性和稳定性。整体而言，目前半导体材料仍是我国半导体产业链的薄弱环节，国产化程度较低且主要集中在中低端产品市场，对进口及外资厂商产品依赖度较高。

引线框架是一种重要的、基础性的半导体封装材料，其引脚与芯片的焊盘通过键合引线进行连接，将芯片的内部信号引出，引线框架发挥电气连接、机械支撑、热管理等作用，对芯片的电气特性、可靠性、散热性产生直接影响，广泛应用于各类半导体产品。随着中国半导体材料企业的不断发展，境内厂商在引线框架的研发和生产上取得了一定进步，但主要集中在复杂度低、品质要求不高的中低端应用领域，国际头部厂商掌握了高精密度、高可靠性、高复杂度的高端核心技术，包含AAMI在内的全球前六大国际化引线框架厂商占据了全球超50%的市场份额[2]，而境内厂商的营收规模普遍较小、技术能力、客户资源、运营经验的积累有限，需要较长时间追赶国际先进水平。随着境内半导体行业的快速发展，下游需求亦逐渐向高端市场迁进，对引线框架的品质和性能要求越来越高，因此引线框架具有较高的本土化需求及必要性。

[2]数据来源：TECHCET、TechSearch International, Inc.、SEMI《Global Semiconductor Packaging Materials Outlook》

3、政策支持上市公司进行并购重组，大力发展新质生产力

近年来，国务院、证监会及交易所不断出台鼓励上市公司并购重组的政策文件。2020年10月，国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，提出要充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，促进市场化并购重组，推动上市公司做优做强，提高上市公司质量。2024年4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出综合运用并购重组、股权激励等方式提高上市公司发展质量，加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的并购，以及收购有助于补链强链、提升关键技术水平的优质资产。2024年11月，深圳市委金融办研究起草了《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》，涉及支持上市公司向新质生产力方向转型发展、持续推进上市公司高质量规范发展、联通中国香港资本市场打通境内外并购资源、支持上市公司开展并购业务"走出去"等具体措施。

目前，并购重组已成为上市公司持续发展、做优做强的重要手段，在市场资源配置方面发挥重要作用，有助于资源要素向新质生产力方向聚集、推动新质生产力稳步发展。

4、政策鼓励吸引外商投资，倡导半导体产业国际合作

国家政策支持上市公司收购境外优质资产，鼓励境内企业吸引外商投资。2020年10月，国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，提出鼓励市场化并购重组，支持境内上市公司发行股份购买境外优质资产，提升上市公司国际竞争力。

2024年3月，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，提出扎实推进高水平对外开放、更大力度吸引和利用外资，扩大鼓励外商投资产业目录，积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单。2024年11月，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《战投管理办法》，从五方面降低了投资门槛，以进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。2025年2月，商务部、发改委制定并经国务院同意的《2025年稳外资行动方案》提出为加大引资稳资力度，要鼓励外资在华开展股权投资，抓好《战投管理办法》落实，引导更多优质外资长期投资我国上市公司。

同时，《国家集成电路产业发展推进纲要》等文件也指出，要鼓励境内集成电路企业扩大国际合作，整合国际资源，拓展国际市场。国际合作对推动我国半导体产业链实现国际化和协同化发展、提升我国半导体产业专业服务能力具有重要积极作用。在2024年1月18日举办的第二十一届中国国际半导体博览会（IC China 2024）上，来自美国、韩国、马来西亚、巴西等国家和地区的半导体国际组织负责人、企业代表、专家学者等参加了相关论坛。

5、电动汽车、算力等新兴产业蓬勃发展，为产业链带来新的增长机遇

汽车电动化、智能化将大幅提升单车的半导体用量，推动汽车半导体行业的快速增长。根据IDC数据，2027年全球的汽车半导体行业将达到880亿美元，相比2023年的年复合增速约达到6.8%，其中分立器件、模拟芯片等细分领域预计将迎来双位数的增长。算力市场在AI大模型的推动下将迎来爆发式增长，有望推动全球半导体市场历过1万亿美元大关，除GPU、CPU等大芯片外，算力产业链中用于电源管理、数据传输、接口控制、安全等类型的芯片亦将同步增长。相比消费类市场，电动汽车、算力等应用市场对半导体的可靠性和稳定性要求更高，AAMI长期以来在高精密度、高可靠性领域积累的技术和经验与之高度契合，将推动AAMI未来的持续成长。

（二）本次交易的目的

1、上市公司进一步拓宽业务布局，全面实现向半导体领域战略转型

为提升上市公司盈利能力、寻找新的利润增长点，上市公司自2022年开始向半导体行业转型，于2023年并表了从事半导体专用设备业务的苏州桔云，苏州桔云主营业务为半导体封装环节的晶圆清洗机、晶圆显影机、晶圆蚀刻机、烘箱等设备的研发和制造，2024年上半年上市公司半导体专用设备业务营业收入占比超过30%。目标公司AAMI与苏州桔云同属半导体产业链企业，在市场开拓、客户资源、技术共享及封装产业趋势理解等方面存在一定协同效应。上市公司响应当前并购重组政策支持上市公司向新质生产力方向转型升级的指导精神，通过本次交易，上市公司将置出线缆用高分子材料业务相关资产及负债，置入半导体封装材料领域优质资产，将资源要素更多投向新质生产力方向，进一步实现向半导体行业的战略转型和产业升级，迎来更大的发展空间。

2、提升境内半导体供应链韧性和安全水平，助力新质生产力发展，打通国际国内双循环

本次交易，上市公司将取得AAMI控制权。引线框架是一种重要的、基础性的半导体封装材料，AAMI作为引线框架行业头部企业，具有先进的生产工艺、高超的技术水平和强大的研发能力，广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，具有悠久的经营历史和良好的品牌声誉。AAMI通过本次交易将成为上市公司子公司，有利于进一步增强境内半导体材料产业实力，尤其是补足境内产业链面向高精密度、高可靠性等高端应用领域的短板，提升半导体产业供应链韧性和安全水平，有助于推动境内新质生产力的发展。同时，AAMI在境内外均有先进产能布局，可同时高效满足境内、境外客户的即时需求，有助于提升产带动的国际产能合作和全球生产经营网络有助于构建中国经济国内国外双循环的发展格局。

3、提升上市公司资产质量，增强公司盈利能力和持续经营能力

本次交易中，上市公司置出亏损资产、置入盈利能力强、发展潜力大的优质标的，能够提升上市公司资产质量和盈利水平。同时，本次交易引入半导体设备领域境外知名上市公司ASMPT的全资子公司ASMPT Holding作为重要股东，ASMPT将在上市公司经营治理和战略决策等方面发挥重要作用，有利于上市公司业务转型升级和长远发展。本次交易是上市公司优化业务布局、增强持续经营能力的积极举措，符合国家产业政策和上市公司发展需求，将切实提高上市公司的盈利能力和持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益。

二、本次交易方案调整

（一）重组方案调整的基本情况

2024年10月23日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议审议通过了预案相关议案，因非关联监事人数不足监事会人数的50%，涉及关联监事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，公司于同日披露了相关公告。截至本报告书摘要签署日，较2024年10月23日披露的重组方案，方案发生以下调整事项：

本次重大资产重组原交易对方北京智路退出本次交易，将其持有的嘉兴景曜、滁州智元的GP财产份额和相关权益转让给先进半导体，由先进半导体在本次交易中将上述GP财产份额和相关权益转让给上市公司；原交易对方马江涛退出本次交易，将其持有的嘉兴景曜4.45%和1.91%财产份额和相关权益分别转让给伍杰和通富微电，由伍杰和通富微电在本次交易中将前述嘉兴景曜4.45%和1.91%财产份额和相关权益转让给上市公司。

除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。

（二）本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

1、现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定

中国证监会2023年2月17日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：

"（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。

（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。

2、本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整

本次交易中上市公司拟直接及间接收购AAMI 99.97%股权，前述方案调整涉及交易对方之间转让的标的资产份额对应AAMI股权比例合计为1.49%，未达到本次交易拟收购的AAMI股权比例的20%，且交易各方同意交易对象之间转让份额，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

（三）本次重组方案调整履行的相关程序

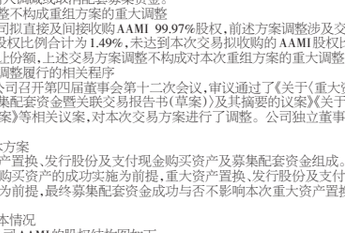
2025年2月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

三、本次交易的具体方案

本次交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）本次交易的基本情况

本次交易前，目标公司AAMI的股权结构图如下：



注：截至本报告书摘要签署日，先进半导体已与北京智路签署受让嘉兴景曜、滁州智元全部GP份额的《合伙份额转让协议》并完成对价支付和经营管理核心资料（包括公章、工商资料、银行账户、各类系统权限等）的交割，工商变更登记正在办理中；伍杰、通富微电已与马江涛签署受让嘉兴景曜LP财产份额的《合伙份额转让协议》并完成对价支付，工商变更登记正在办理中。

上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%的股权及其控制权并置出上市公司全资子公司至新材料100%股权，并募集配套资金。

在境内，上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式收购AAMI上层出资人持有的有关权益份额，包括（1）以其持有的至正新材料100%股权作为置出资产，与先进半导体持有的嘉兴景曜之GP财产份额和相关权益的等值部分进行置换，针对置换差额部分，由上市公司以支付现金和发行股份方式向先进半导体进行购买；（2）支付现金购买滁州智元中先进半导体作为GP拥有的全部财产份额和相关权益；（3）发行股份购买嘉兴景曜中厚熙宸浩、陈永阳、伍杰、通富微电作为LP拥有的全部财产份额和相关权益；（4）发行股份购买滁州智元之LP滁州广泰中领先半导体、通富微电、海纳基石、海南博林、张燕、伍杰作为LP拥有的全部财产份额和相关权益；（5）发行股份购买滁州智合中芯绣咨询持有的1.99%股权。

在境外，上市公司拟发行股份及支付现金收购ASMPT Holding持有的AAMI 49.00%股权，在上市公司取得AAMI控制权的同时，AAMI将支付现金回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易完成后，目标公司将成为上市公司控股子公司，上市公司将直接和间接持有AAMI约99.97%股权，上市公司全资子公司正信共创将担任滁州智元、嘉兴景耀的普通合伙人。相关股权结构及控制关系如下图所示：

上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹资金。在募集配套资金到位之前，上市公司将根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

（二）发行股份的基本情况

1、交易价格及定价依据

（1）拟置入资产的估值及定价

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联沪评字【2025】第8号），以2024年9月30日为基准日，选用市场法评估结果作为评估结论，目标公司AAMI 100%股权的评估值为352,600.00万元。

本次交易拟置入标的中，滁州智合、嘉兴景耀、滁州智元、滁州广泰均系为投资AAMI而设立的企业，除持有AAMI股权外，不存在其他业务。结合本次交易方案以及AAMI上层股权结构，考虑评估基准日期后重大事项调整，本次交易拟置入标的合计直接及间接持有AAMI 99.97%股权和各持股主体中除下层投资外的其他净资产611.92万元。上述纳入本次交易范围内的拟置入标的资产价值可根据AAMI 100%股权估值及上层各持股主体的审定数据进行测算，在不考虑控制权溢价和少数股权折价的情况下，经换算，本次交易拟置入资产的参考价值为353,072.55万元。

本次交易拟置入资产作价，在上述参考价值的基础上，经交易各方友好协商，拟置入资产的总对价为350,643.12万元，本次交易拟置入资产的交易作价不超过拟置入资产的参考价值，符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

本次交易拟置入资产的定价以AAMI 100%股权评估价值、AAMI上层各持股主体中其他净资产的审计财务数据作为参考价值，经交易各方通过自主协商确定，交易作价不超过拟置入资产的参考价值，符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

（2）拟置出资产的估值及定价

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联沪评字【2025】第9号），以2024年9月30日为基准日，选用资产基础法评估结果作为评估结论，至正新材料100%股权的评估值为25,637.34万元。

经交易各方友好协商，拟置出资产作价为25,637.34万元。

2、支付方式及对价明细

本次交易涉及的支付对价及支付方式如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式			向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	其他	
1	ASMPT Holding	AAMI 49.00%股权	78,879.37	92,800.00	无	171,679.37
2	领先半导体	滁州广泰40.62%财产份额和相关权益	无	16,439.38	无	16,439.38
3	通富微电	滁州广泰31.90%财产份额和相关权益；嘉兴景耀1.91%财产份额和相关权益	无	21,500.00	无	21,500.00
4	张燕	滁州广泰8.93%财产份额和相关权益	无	5,600.00	无	5,600.00
5	海纳基石	滁州广泰7.97%财产份额和相关权益	无	5,000.00	无	5,000.00
6	伍杰	滁州广泰6.38%财产份额和相关权益；嘉兴景耀4.45%财产份额和相关权益	无	7,500.00	无	7,500.00
7	海南博林	滁州广泰3.99%财产份额和相关权益	无	2,500.00	无	2,500.00
8	先进半导体	嘉兴景曜、滁州智元2家合伙企业之GP的全部财产份额和相关权益	200.00	38,129.86	拟置出资产，作价25,637.34	63,967.20
9	陈永阳	嘉兴景曜7.63%财产份额和相关权益	无	6,000.00	无	6,000.00
10	厚熙宸浩	嘉兴景曜5.09%财产份额和相关权益	无	4,000.00	无	4,000.00
11	芯绣咨询	滁州智合1.99%股权	无	2,685.04	无	2,685.04
12	香港智信	AAMI 12.49%股权	现金回购，43,772.13	无	无	43,772.13
合计		-	122,851.50	202,154.28	25,637.34	350,643.12

3、发行对象

本次交易发行股份的交易对方为ASMPT Holding、通富微电、领先半导体、先进半导体、海纳基石、海南博林、厚熙宸浩、陈永阳、张燕、伍杰、芯绣咨询等交易对方。

4、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

5、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第十次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下：

交易均价计算类型	交易均价（元/股）	交易均价的80%（元/股）
定价基准日前20个交易日	50.12	40.10
定价基准日前60个交易日	42.68	34.15
定价基准日前120个交易日	37.92	30.34

经交易各方友好协商，本次发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

6、发行股份数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量为63,173,212股（计算公式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和），计算结果出现数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。具体如下：

序号	交易对方	股份对价金额（万元）	发行数量（股）
1	ASMPT Hong Kong Holding Limited	92,800.00	29,000,000
2	南宁市先进半导体科技有限公司	38,129.86	11,915,580
3	通富微电子股份有限公司	21,500.00	6,718,750
4	深圳市领先半导体发展有限公司	16,439.38	5,137,307
5	伍杰	7,500.00	2,343,750
6	陈永阳	6,000.00	1,875,000
7	张燕	5,600.00	1,750,000
8	深圳海纳基石投资有限公司	5,000.00	1,562,500
9	嘉兴厚熙宸浩股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000.00	1,250,000
10	芯绣咨询管理（上海）有限公司	2,685.04	839,075
11	海南博林京融创业投资有限公司	2,500.00	781,250
合计		202,154.28	63,173,212

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量将作相应调整。最终发行的股份数量以中国证监会注册确定的数量为准。

7、股份锁定期

ASMPT Holding因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让；但若ASMPT Holding通过本次交易取得上市公司股份时，ASMPT Holding用于认购上市公司股份的部分资产持续拥有权益的时间不足12个月，则ASMPT Holding通过本次交易取得的对应部分上市公司股份自该对应部分股份发行结束之日起36个月内不得转让。如前述股份发行不符合《战投管理办法》第四条、第五条、第六条、第七条规定条件，被上海证券交易所、中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门认定为通过虚假陈述等方式违规对上市公司实施战略投资的，在满足相应条件前及满足相应条件后12个月内，ASMPT Holding因本次交易取得的上市公司股份不进行转让、赠与或者质押，不参与分红，不就ASMPT Holding因本次交易取得的上市公司股份行使表决权或者对表决权施加影响。

芯绣咨询因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。

领先半导体、先进半导体因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，领先半导体、先进半导体持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

通富微电、海纳基石、海南博林、厚熙宸浩、陈永阳、张燕、伍杰因本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得以任何方式转让，但若其通过本次交易取得上市公司股份时，持续拥有用于认购上市公司股份的合伙份额权益的时间不足12个月，则其通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份及因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。

若上述限售期安排与届时有效的法律、法规、部门规章及规范性文件的规定不相符或与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关规定或监管意见相应调整。

8、过渡期损益安排

过渡期内，拟置入资产在运营过程中产生的盈利及/或因其他原因而增加的净资产）在交割日后由上市公司最终全部享有；拟置入资产在运营过程中产生的亏损或因其他原因而减少的净资产，交割日后由交易对方按照交割日前各自直接或间接所持拟置入资产的股权或份额比例承担。

过渡期内，拟置出资产至正新材料所产生的盈利及亏损均由先进半导体承担。

9、滚存未分配利润安排

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

（三）发行股份募集配套资金

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

3、发行对象

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

4、发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过100,000.00万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用，以及偿还借款，未超过本次交易中发行股份购买资产的交易价格的100%，用于偿还借款的募集资金金额不超过本次交易中发行股份购买资产的交易价格的25%或募集配套资金总额的50%。配套募集资金发行股份数量不超过22,360,499股，未超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按照《发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

5、锁定期安排

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

6、滚存未分配利润安排

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

（四）目标公司少数股权的后续收购安排

北京建广已经同意滁州广泰之LP参与本次交易，但北京建广出售其持有的滁州广泰GP份额（对应AAMI约0.03%股权）需履行国有资产转让相关程序，因此该等GP财产份额和相关权益暂未纳入本次交易的收购范围。

北京建广出具承诺，上市公司或指定主体同意受让北京建广持有滁州广泰的全部GP份额，交易价格以本次收购中AAMI的整体估值及滁州广泰的资产、负债情况为基础，并结合北京建广间接持有的AAMI股份比例综合确定最终价格（简称"交易价格"）。

此外，领先半导体和上市公司实际控制人王强先生向北京建广出具了承诺，承诺上市公司实际控制人及其关联方或领先半导体因自身原因未参与GP份额的摘牌导致北京建广转让GP份额价格低于前述价格或未能成功转让的，领先半导体和上市公司实际控制人王强先生将承担相应的价款补偿责任。

四、本次交易的性质

（一）本次交易是否构成重大资产重组

根据上市公司、目标公司AAMI以及拟置出标的的相关财务数据、本次交易作价情况，本次交易构成重大资产重组，具体的指标计算情况如下：

1、本次交易拟置入资产

本次交易拟置入资产导致本次交易构成重大资产重组，具体指标计算情况如下：

单位：万元

财务指标	上市公司	拟置入资产（AAMI财务数据）	拟置入资产交易作价	计算指标	指标占比
	2023年度	2024年9月30日			
资产总额	60,074.93	394,997.17	350,643.12	394,997.17	657.51%
资产净额	25,634.18	296,593.77		350,643.12	1367.87%
财务指标	2023年度	2023年度	/	计算指标	指标占比
营业收入	23,941.92	220,530.39	/	220,530.39	921.11%

注：表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

2、本次交易拟置出资产

本次交易拟置出资产导致本次交易构成重大资产重组，具体指标计算情况如下：

单位：万元

财务指标	上市公司	至正新材料	计算指标	指标占比
	2023年度	2024年9月30日		
资产总额	60,074.93	39,606.02	39,606.02	65.93%
资产净额	25,634.18	22,278.99	22,278.99	86.91%
财务指标	2023年度	2023年度	计算指标	指标占比
营业收入	23,941.92	16,199.03	16,199.03	67.66%

注：表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

根据《重组管理办法》第十四条，上市公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。基于上述测算，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。

（二）本次交易是否构成关联交易

本次交易中，交易对方领先半导体、先进半导体均为上市公司实际控制人王强先生控制的主体，为上市公司的关联方；此外，本次交易完成后，ASMPT Holding持有上市公司的股份比例将超过5%，将成为上市公司的关联方。综上所述，本次交易构成关联交易。

上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易是否构成重组上市及判断依据

上市公司实际控制人王强先生于2020年5月21日取得上市公司控制权，距本次交易上市公司停牌时间（2024年10月11日）已超过36个月。本次交易前，上市公司控股股东为深圳市正信创投资发展有限公司，实际控制人为王强先生；本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为王强先生，按配套融资发行22,360,499股测算，王强先生通过正信同创、先进半导体、领先半导体合计持有上市公司37,177,337股股份，占届时上市公司总股本的23.23%，且ASMPT Holding已出具《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺》。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

本次交易前后，持有上市公司百分之五以上股份的股东以及上市公司的业务构成都将发生较大变化。（1）按配套融资发行22,360,499股测算，配套融资发行后，ASMPT Holding持有上市公司29,000,000股股份，占届时上市公司总股本的18.12%，ASMPT Holding已出具《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺》，自承诺函出具之日至本次交易交割完成后36个月内，①不会以任何方式谋求上市公司的控制权；②不会协助或促使上市公司其他股东或本次交易其他交易对方通过任何方式谋求上市公司的控制权。（2）截至本报告书摘要签署日，除因本次交易导致上市公司置入半导体引线框架业务并置出高分子线缆业务外，上市公司暂无进一步调整主营业务的相关安排。如未来三十六个月内上市公司拟进一步调整主营业务，上市公司将严格按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所之相关规定及时履行相应的信息披露义务。

五、本次交易对于上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

2022年开始，上市公司向半导体行业实施战略转型，本次交易前，上市公司主要业务包括电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，以及半导体专用设备的研发、生产和销售。2024年上半年，上市公司半导体专用设备业务营业收入占比超30%。

本次交易完成后，上市公司将置入半导体引线框架的研发、设计、生产与销售业务，并置出原有的线缆用高分子材料业务，上市公司将专注于半导体封装材料和专用设备，落实上市公司聚焦半导体产业链的战略转型目标。引线框架是半导体封装中不可或缺的基础材料之一，具备电气连接、机械支撑、热管理等核心功能，直接影响芯片成品的电气特性、可靠性、散热性等关键指标。AAMI是全球前五的引线框架供应商，客户广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，产品广泛应用于汽车、计算、通信、工业、消费等下游领域。本次交易有助于上市公司获得先进的引线框架资产，成为A股市场在引线框架赛道的稀缺标的，提升上市公司的持续经营能力，落实向半导体行业转型的战略。同时，本次交易完成后AAMI控制权注入上市公司，将利用上市公司平台持续发展，进一步助力夯实境内半导体产业链的自主可控，尤其是补足境内产业链面向高精密度、高可靠性等高端应用领域的短板，提升半导体产业链供应链韧性和安全水平，并通过核心原材料的供应助推国产半导体产业向高端领域迈进，助力我国新质生产力的发展。

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及上会会计师出具的《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司主要财务数据情况如下：

项目	2024年9月30日/2024年1-9月			2023年12月31日/2023年		
	交易前	备考数	变动	交易前	备考数	变动
资产总计（万元）	63,735.55	466,139.23	631.36%	60,074.93	449,023.13	647.44%
负债合计（万元）	35,976.58	140,599.28	290.81%	30,969.02	119,662.93	286.40%
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	24,126.72	321,698.57	1,233.37%	25,634.18	325,795.77	1,170.94%
营业收入（万元）	19,319.01	187,492.87	870.51%	23,941.92	228,273.28	853.45%
归属于母公司所有者净利润（万元）	-1,507.47	1,712.45	由负转正	-4,442.35	-1,060.93	亏损减少
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.24	20.10	520.87%	3.44	20.35	491.80%
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.11	增加0.31	-0.60	-0.07	增加0.53
稀释每股收益（元/股）	-0.20	0.11	增加0.31	-0.60	-0.07	增加0.53

本次交易后，上市公司的资产规模、归母净利润将大幅增加，有利于增强上市公司抗风险能力和持续经营能力，上市公司资产质量和整体经营业绩显著提升，符合上市公司全体股东的利益。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响